

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengendalian *defect chipping die* pada mesin *Die Attach* di PT.Epson Batam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian *Defect* dengan metode PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dengan melakukan analisis FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*) telah teridentifikasi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *defect chipping die* adalah faktor metode kerja; jadwal *cleaner* yang menyebabkan terdapat *dust* atau *foreign material* pada *metal collet*, faktor manusia; tidak menjalankan SOP, dan faktor mesin; *metal collet* yang miring.
2. Dengan melakukan analisis OPC (*operational process chart*) diketahui bahwa solusi pengendalian yang tepat untuk mengurangi *defect chipping die* pada mesin *Die Attach* adalah menerapkan SOP usulan dengan membuat *shifty cleaning metal collet* atau proses *cleaning* dua kali sehari pada mesin *Die Attach*.

5.2 Saran

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab *defect*.
Melakukan analisis PDCA dengan menggunakan metode lain seperti *sigma six* dan 5W1H
2. Solusi perbaikan alternatif selain SOP Perusahaan
3. Menggunakan data penelitian dengan periode yang lebih panjang